

MU733

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、MU733のご紹介です。



MU733

ファーウェイ・ジャパン
[華為技術日本株式会社]
超薄型TFF通信モジュール



特長

- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応(3Gハイスピード)
- ・SMS通信
- ・国際ローミング
- ・IP着信 (国内)

スペック

製品名	MU733
サイズ	40×20×2mm (H×W×D)
重量	約4g
通信方式	HSPA+/HSPA/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE
周波数	3G: 2100、900MHz GSM: 1900、1800、900、850MHz
通信速度*	下り: 21Mbps 上り: 5.7Mbps
電源電圧	DC 3.3~4.2V (推奨 3.7V)
消費電流	通信時: 約230mA (3.7V、HSDPA: 10dBm Tx) 待受時: 約1.7mA (3.7V、Standby)
外部インターフェース	B to Bコネクタ (50ピン) 通信用インターフェース: USB2.0 × 1
アンテナコネクタ	W.FLコネクタ
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度: -10°C~55°C 保存温度: -40°C~85°C 湿度: 5~95%
取得済み認証	JATE、TELEC (国内) FCC、CE、GCF、PTCTRB、RoHS、CCC、KCC、NCC、IC、A-Tick、Gost、NTC、TRA、DGPT、CNC、SIRIM、ICASA、ANATEL

本製品はHuawei Technologies社製造、代理店より販売いたします。

※ 海外でのご利用を含め、地域によって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.huawei.com/jp/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。